



SCIENTECH

辛耘

許明棋 2026/08/27

- 本簡報可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時又受限於已知或未知的風險與不確定性的影響。因此實際結果將可能不同於表述內容。
- 除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生，主動更新對未來展望的表述。



公司簡介

基本資料 | 公司歷程 | 全球據點 | 組織架構





產品與服務

- 設備研發製造-Equipment Design and Manufacturing
- 晶圓再生-Wafer Reclaim
- 代理事業-Representative



我們服務的產業

- 半導體 (前段/先進封裝)-Semiconductor (Front-End and Advanced Packaging)
- 化合物半導體-Compound Semiconductor
- LED / Mini LED / Micro LED
- 平面顯示器-Flat Panel Display (TFT-LCD, AMOLED, Touch Panel)
- IC封裝基板(IC Package Substrate)



設立年度:
1979
Taipei, Taiwan

實收股本:
US\$ 27 Million
TWSE:3583

員工人數:
>1,150 (全球)

員工人數

[ABOUT US](#) [PRODUCTS](#) [CONTACT US](#)



超過 1,150 員工

代理事業

- 台灣:135
- 大陸:130
- 70%具設備製程與工程經驗

設備研發與製造

- 450 員工
- 130以上同仁具有研發設計與製程與工程經驗

再生晶圓

- 335 員工

管理部

- 105 員工

公司歷程

ABOUT US PRODUCTS CONTACT US



SCIENTECH

1979

設立於台北



1985

新竹辦公室, Taiwan

1995

美國子公司(加州)

2001

大陸子公司(上海)

2002

新加坡代理商

2003

自製機台研發與製造

2021

歐洲子公司(奧地利)

2019

自製設備500台出貨

2013

辛耘在台灣交易所上市掛牌

2007

湖口廠辦大樓落成

2006

晶圓再生事業

2004

新竹辦公大樓

台北總公司

新竹辦公大樓

湖口廠辦大樓

- 設備研發製造
 - ◆ 配備10級/1000級/10000級無塵室
- 再生晶圓



台中辦公室

高雄辦公室

台南辦公室

歐洲子公司

Villach, Austria (2020)

- 負責提供歐洲客戶一條龍銷售與客服
- 本公司及歐洲客戶對接窗口
- 新產品/產品開發

美國子公司

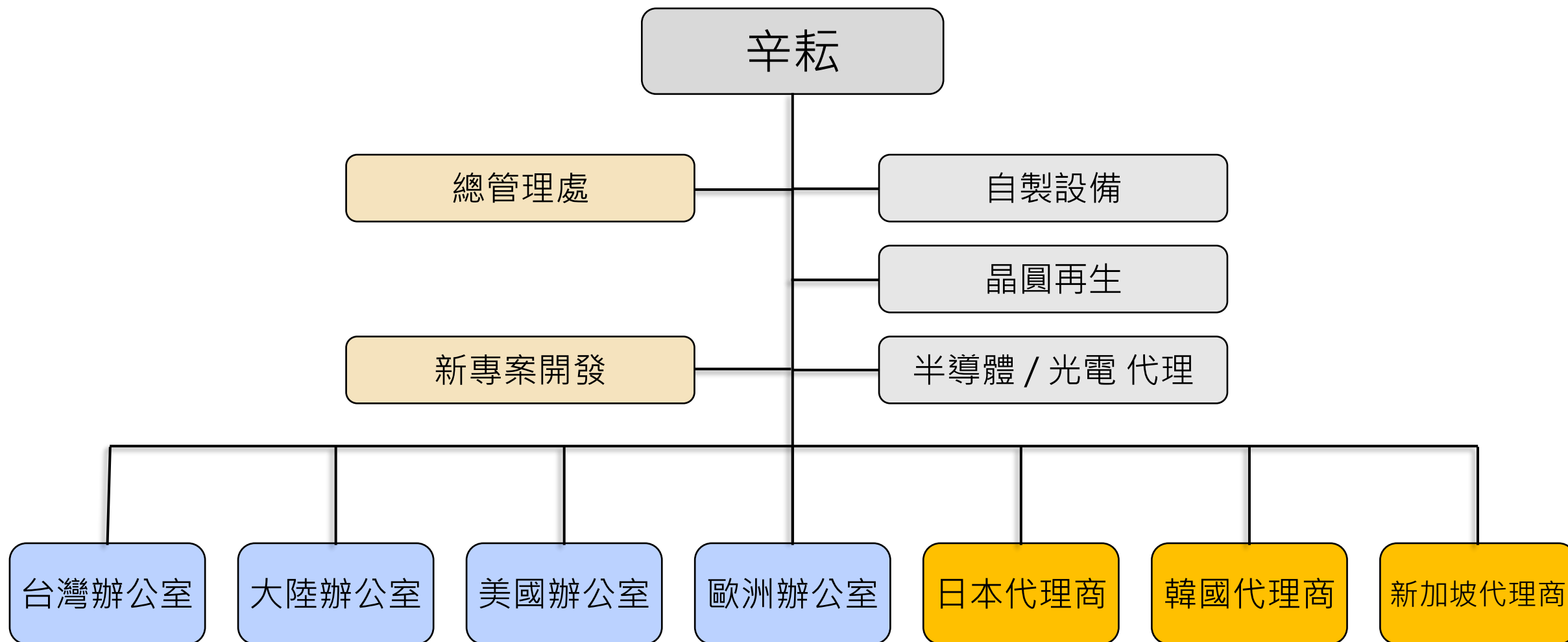
Santa Clara, CA (1994)

- 負責銷售與客服服務
- 負責原廠與美國客戶對接服務
- 新產品/產品開發

大陸子公司

- 北京辦事處 (2004年)
- 大連辦事處 (2012年)
- 西安辦事處 (2013年)
- 重慶辦事處 (2010年)
- 常州辦事處 (2012年)
- 無錫辦事處 (2003年)
- 上海辦事處 (2001年)
- 蕪湖辦事處 (2013年)
- 廈門辦事處 (2011年)
- 惠州辦事處 (2013年)
- 昆明辦事處 (2002年)

辛耘公司組織架構



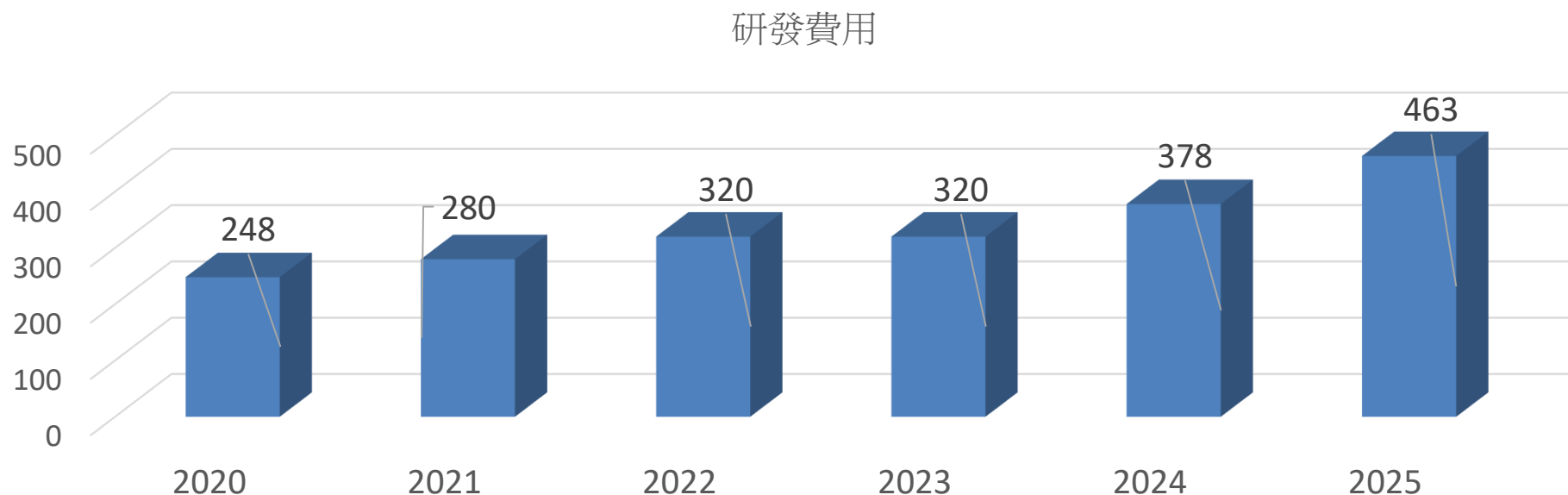
產品與服務

設備研發與製造 | 晶圓再生 | 代理事業



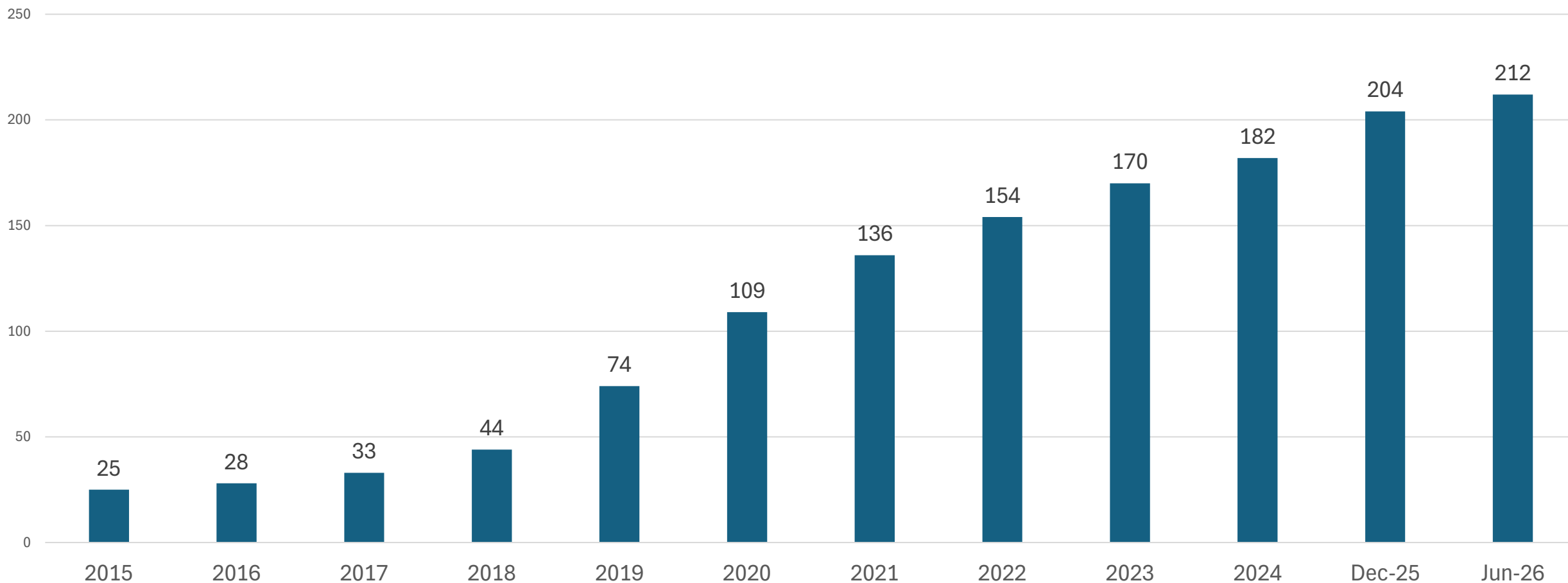
研發費用

單位：百萬	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026/Q2
研發費用	248	280	320	341	378	463	314
研發費用佔 營業收入比重	6.9%	6.0%	5.7%	4.9%	3.9%	4.0%	5.1%
研發費用佔 製造比重	16.5%	14.9%	15.3%	15.7%	11.3%	9.8%	10.0%



- 在案專利累積數**212**件；申請中**50**件

專利





設備研發與製造

- 新進封裝-Advanced Package
- 半導體前段製程-FEOL
- 光罩-Mask
- 化合物-Compound
- 其他



再生晶圓

- 12" Si Wafer



代理事業

- 設備/量測設備
- 子系統-Sub-System
- 材料-Material
- 維修和翻新-Repair and Refurbish

先進的清潔技術

- **19nm Particle**
- **Low Trace Metal (<1E9)**

進階缺陷檢測

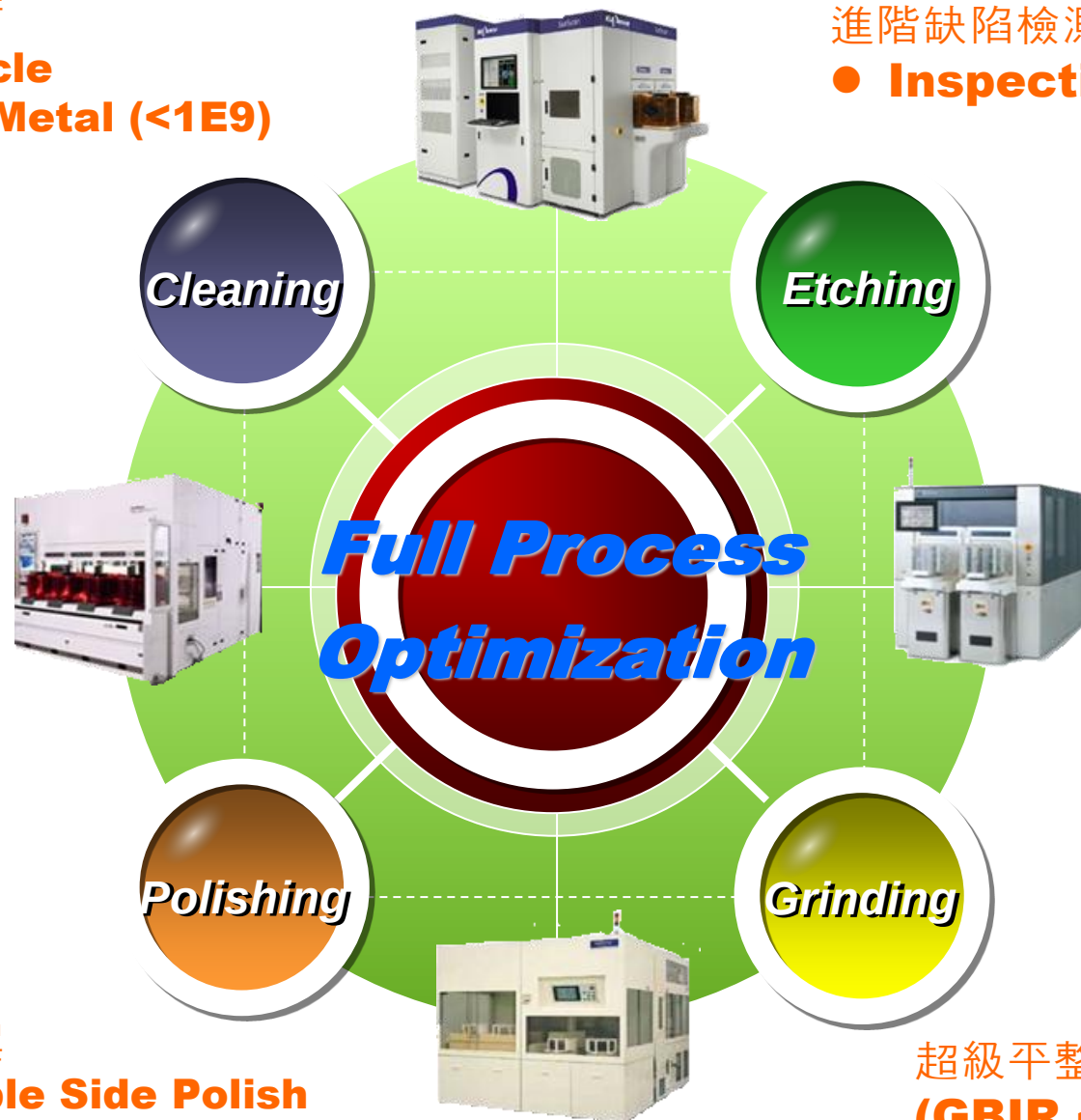
- **Inspection (SP1/SP2/SP5/SP7)**

12" 矽晶圓

- 產能: 210K / 月
- 銅與非銅製程

產能擴充計畫

- 2026年底再增加月產能 40K



完整的拋光製程

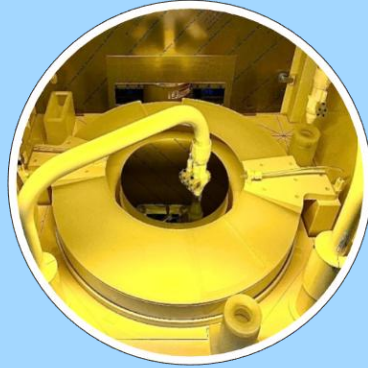
- **Single/Double Side Polish**
- **Final Haze Polish**

超級平整度

(GBIR < 0.5mm)



批次式濕式製程



單晶圓濕式製程



暫時性貼合及剝



烘烤設備

批次式濕式製程設備

應用產業

- Semiconductor: FEOL, BEOL, Compound
- Advanced Packaging/Bumping...

製程應用

- Etch: Metal/Oxide/Nitride remove
- Stripper: PR/PI strip, Polymer remove
- Clean: Pre/Post/Flux clean
- Electro-less Plating: Zn/Ni/Pd/Au

功能特色

- Cassette type or Cassette-less type
- Adopted by big international companies
- Leading-edge technologies



單晶圓濕式製程設備

應用產業

- Semiconductor: BEOL, FEOL, Compound
- Advanced Packaging/Bumping

製程應用

- UBM / Metal Etch
- Flux Clean (Hot DIW)
- PR Strip
- Wafer Clean (APC, Soft spray)
- Final Clean/Mask Clean/Frame Clean

功能特色

- Soak/Immersion + Single
- Adopted by big international companies
- Leading-edge technologies



暫時性貼合及剝離設備(TBDB)

應用產業

- IGBT & SiC Power Device
- Advanced Packaging for Semiconductor

功能特色

- User-friendly graphical user interface
- Adopted by big international companies
- Leading-edge technologies

製程應用

- Temporary Bonding
- Temporary De-bonding
- Release Layer Coating
- Carrier (Glass) Recycling



水氣烘烤設備

應用產業

- Semiconductor: BEOL
- Advanced Packaging for Semiconductor

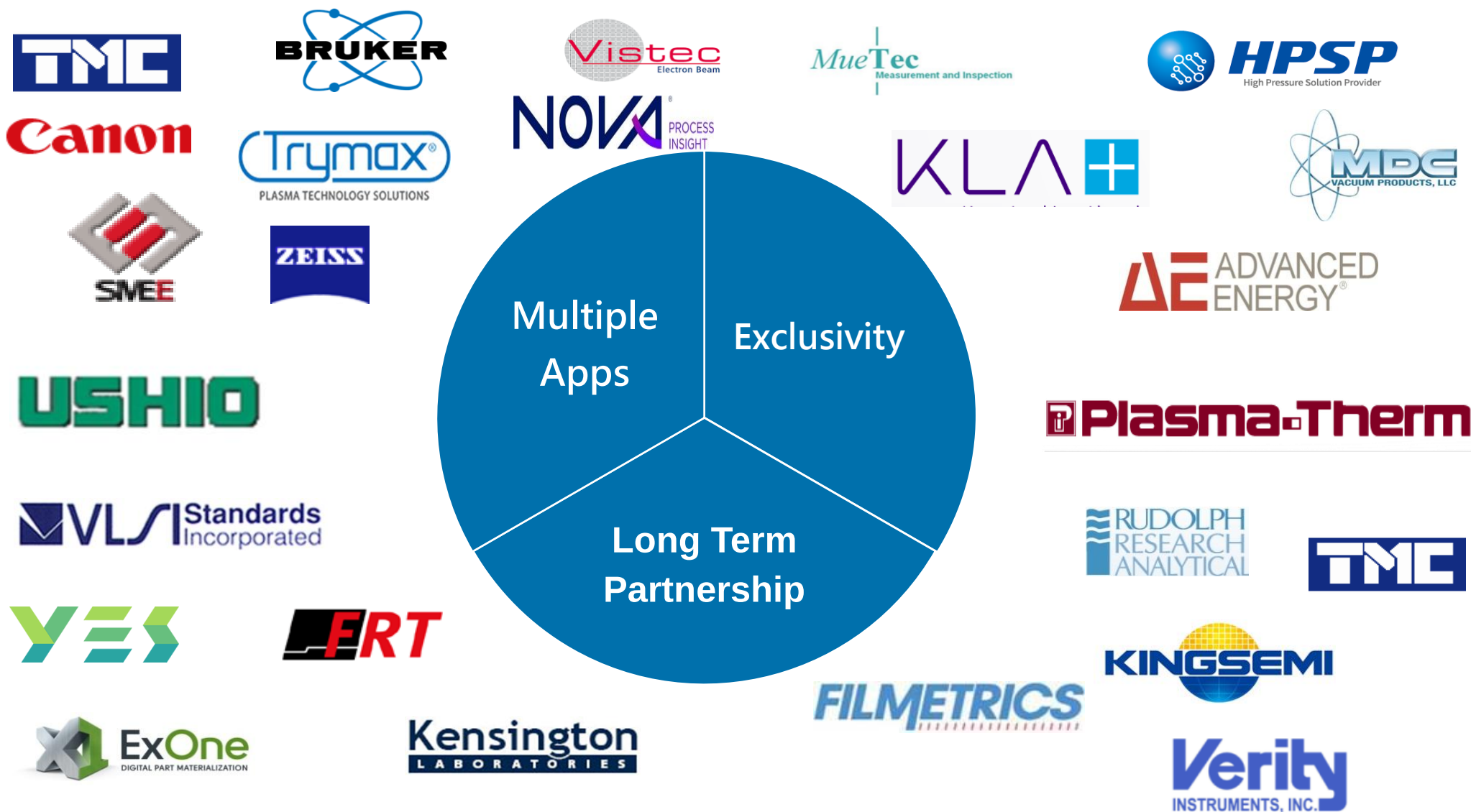
製程應用

- Pre-underfill baking
- Pre-mold baking
- DFR Hard Bake

功能特色

- Availability for horizontal or vertical process
- High precision temperature control
- Weight handling capacity up to 23kg per lot



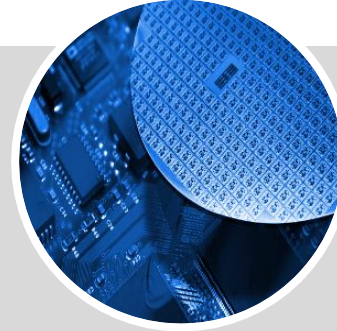




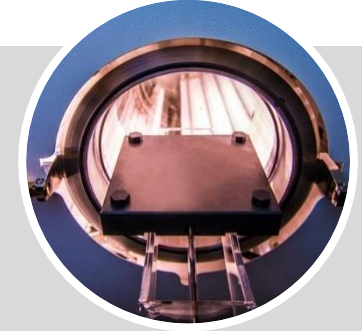
Lithography



Etch



Thin Film



Diffusion





Metrology



Sub-Systems



Package & Material



Robot Repair and Refurbish



公司治理





發行永續報告書



E



環境友善

S



溫馨職場



回饋社會

G



誠信經營



SEMICON®

Semicon China

Mar. 25-27, 2026
Shanghai



SEMICON®

Semicon TW

Sep. 2-4, 2026
Taipei



SEMICON®

Semicon West

Oct. 13-15, 2026
San Francisco



SEMICON®

Semicon Europa

Nov. 10-13, 2026
Munich



ISES

May 12-15, 2026
Taipei



ECTC

May 26-29, 2026
Orlando, Florida

營運概況

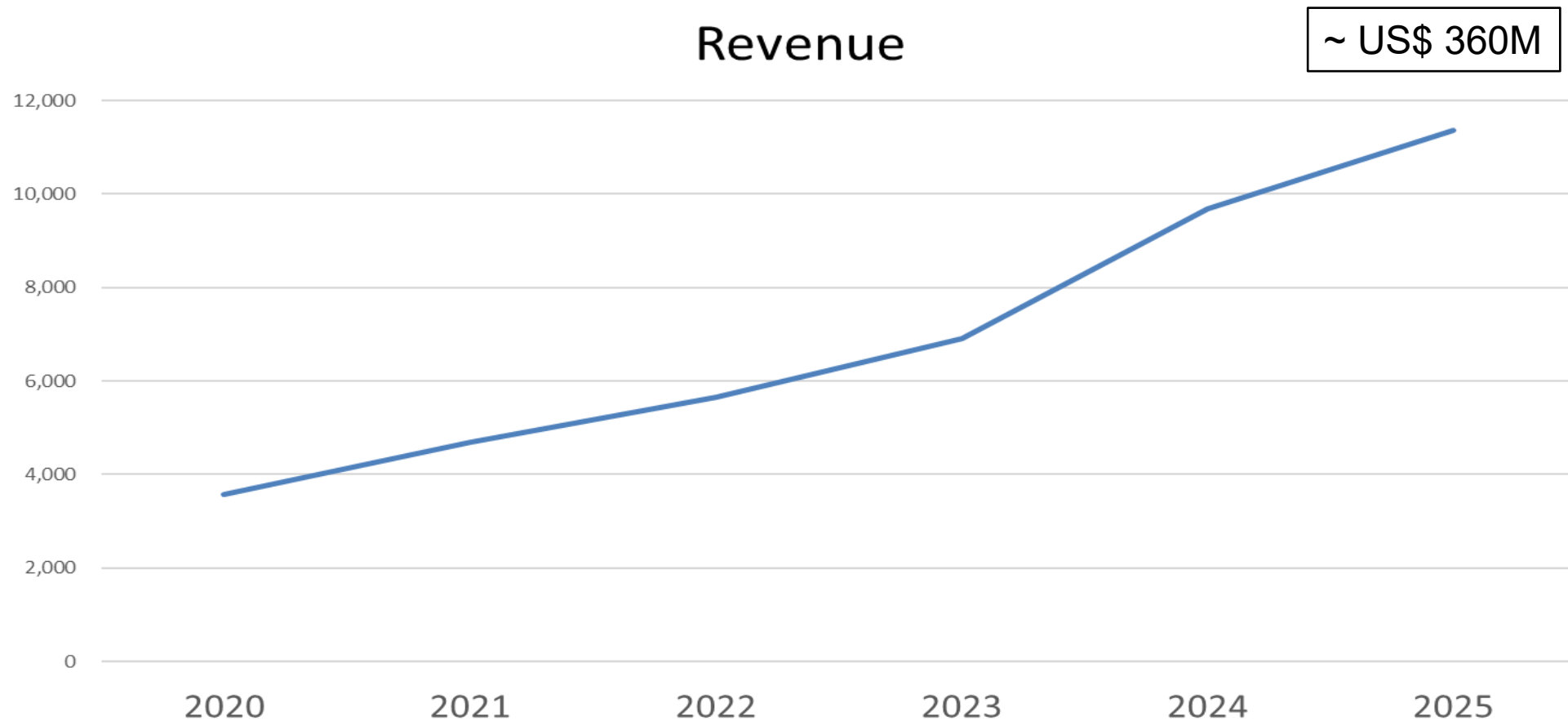


簡明損益表

單位：新台幣百萬	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026/Q2
營業收入	3,580	4,684	5,650	6,911	9,688	11,371	6,115
營業毛利	1,456	1,667	2,084	2,201	2,906	3,814	2,256
營業費用	991	1,112	1,374	1,483	1,790	2,238	1,349
營業淨利	465	555	710	718	1,116	1,576	908
稅前淨利	389	524	736	860	1,277	1,540	958
歸屬母公司淨利	305	420	568	650	927	1,110	739
EPS(新台幣元/股)	<u>3.80</u>	<u>5.23</u>	<u>7.08</u>	<u>8.10</u>	<u>11.54</u>	<u>13.82</u>	<u>9.16</u>
毛利率	41%	36%	37%	32%	30%	34%	37%
營業淨利率	13%	12%	13%	10%	12%	14%	15%
稅前淨利率	11%	11%	13%	12%	13%	14%	16%

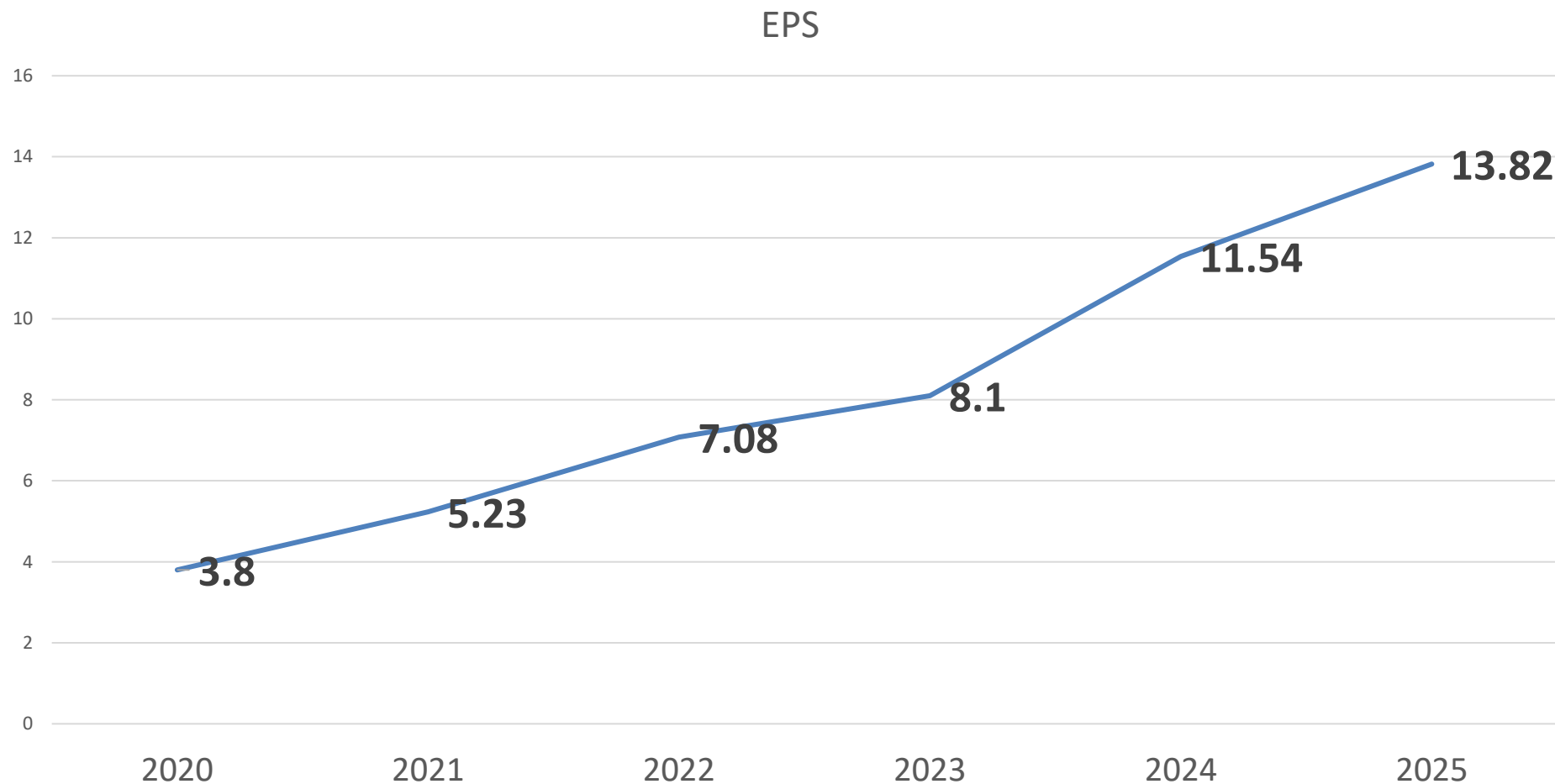
歷年營收

單位: 新台幣百萬	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025/Q2	2026/Q2
營業收入	3,580	4,684	5,650	6,911	9,688	11,371	5,726	6,115



歷年 EPS

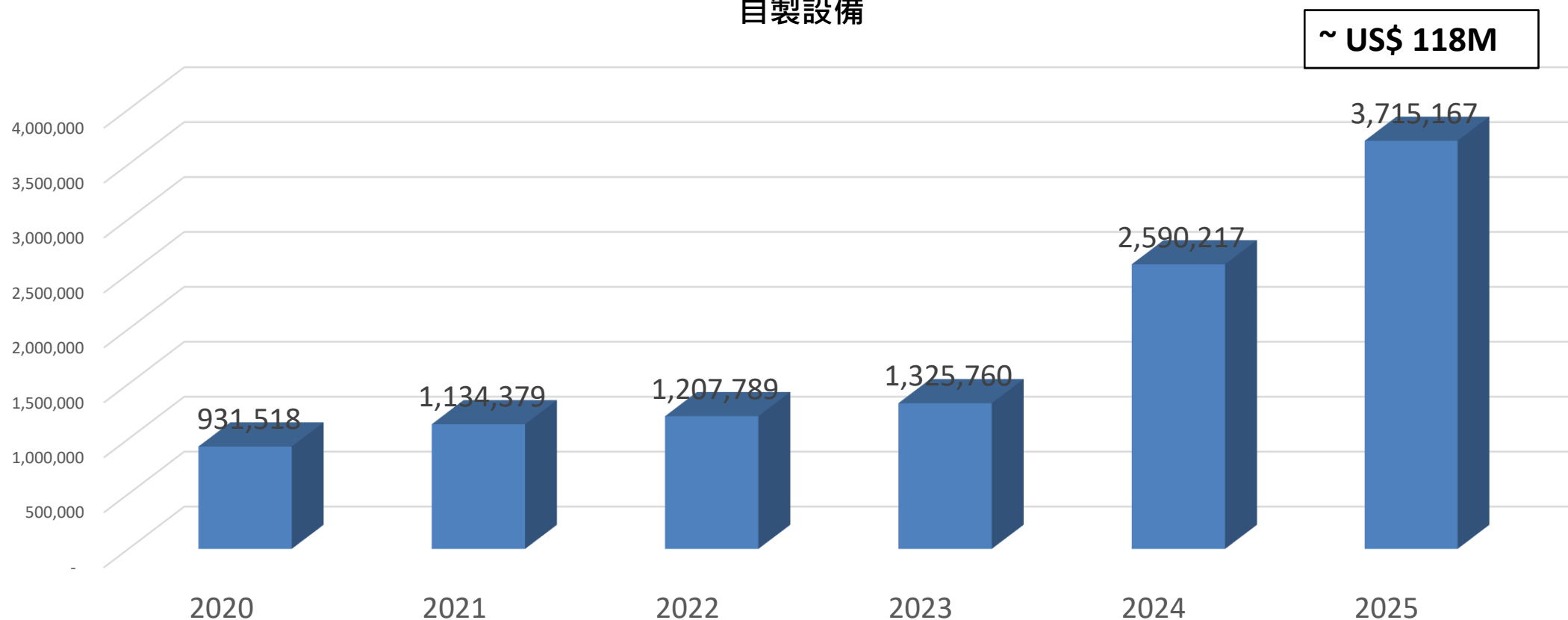
單位：NTD	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026/Q2
EPS	3.80	5.23	7.08	8.10	11.54	13.82	9.16



自製設備營業收入

營業收入	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026/Q2	2026
自製設備	931,518	1,134,379	1,207,789	1,325,760	2,590,217	3,715,167	2,562,617	

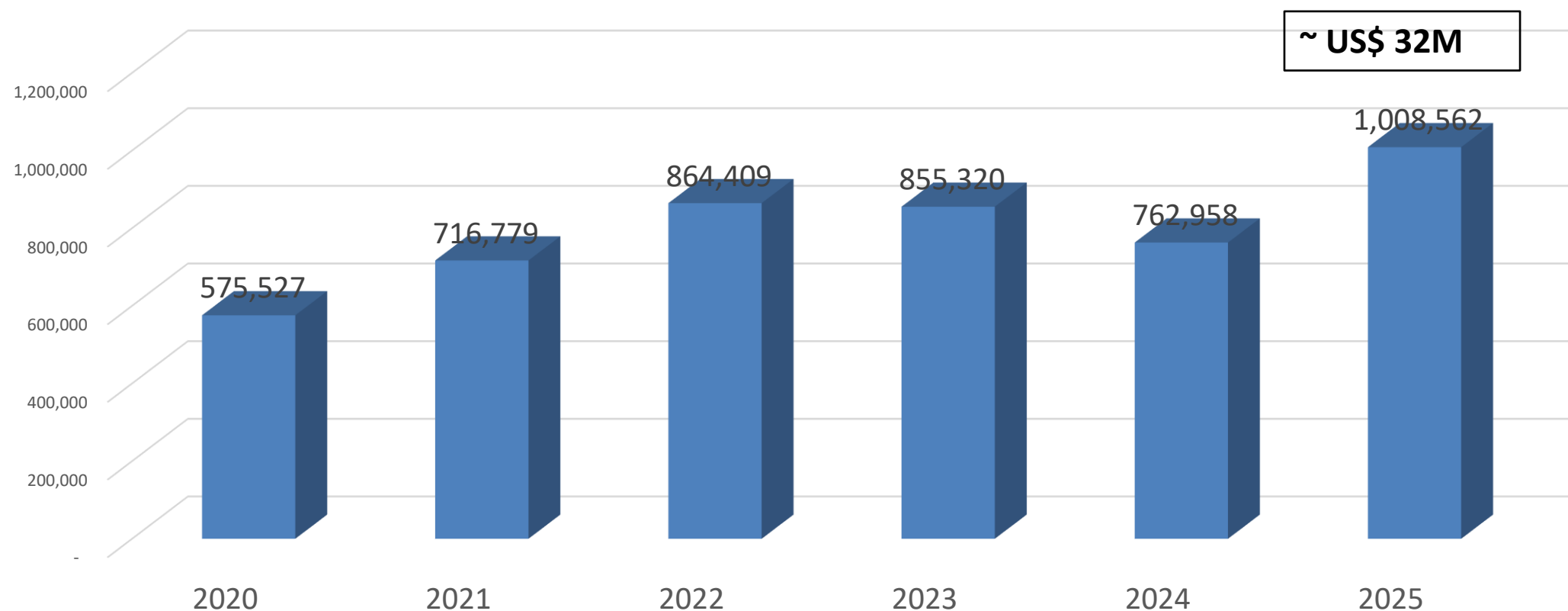
自製設備



晶圓再生營業收入

營業收入	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026/Q2	2026
晶圓再生	575,527	716,779	864,409	855,320	762,958	1,008,562	594,674	

晶圓再生

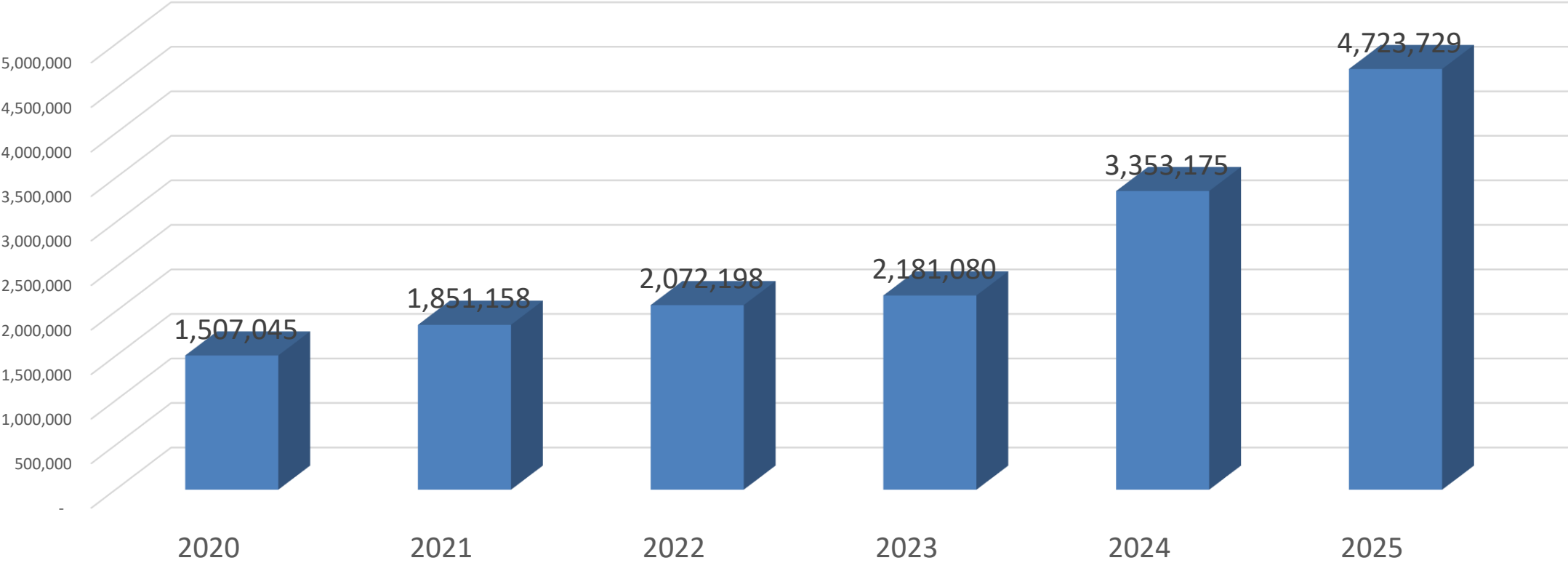


製造業營業收入

營業收入	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026/Q2	2026
製造業	1,507,045	1,851,158	2,072,198	2,181,080	3,353,175	4,723,729	3,157,291	

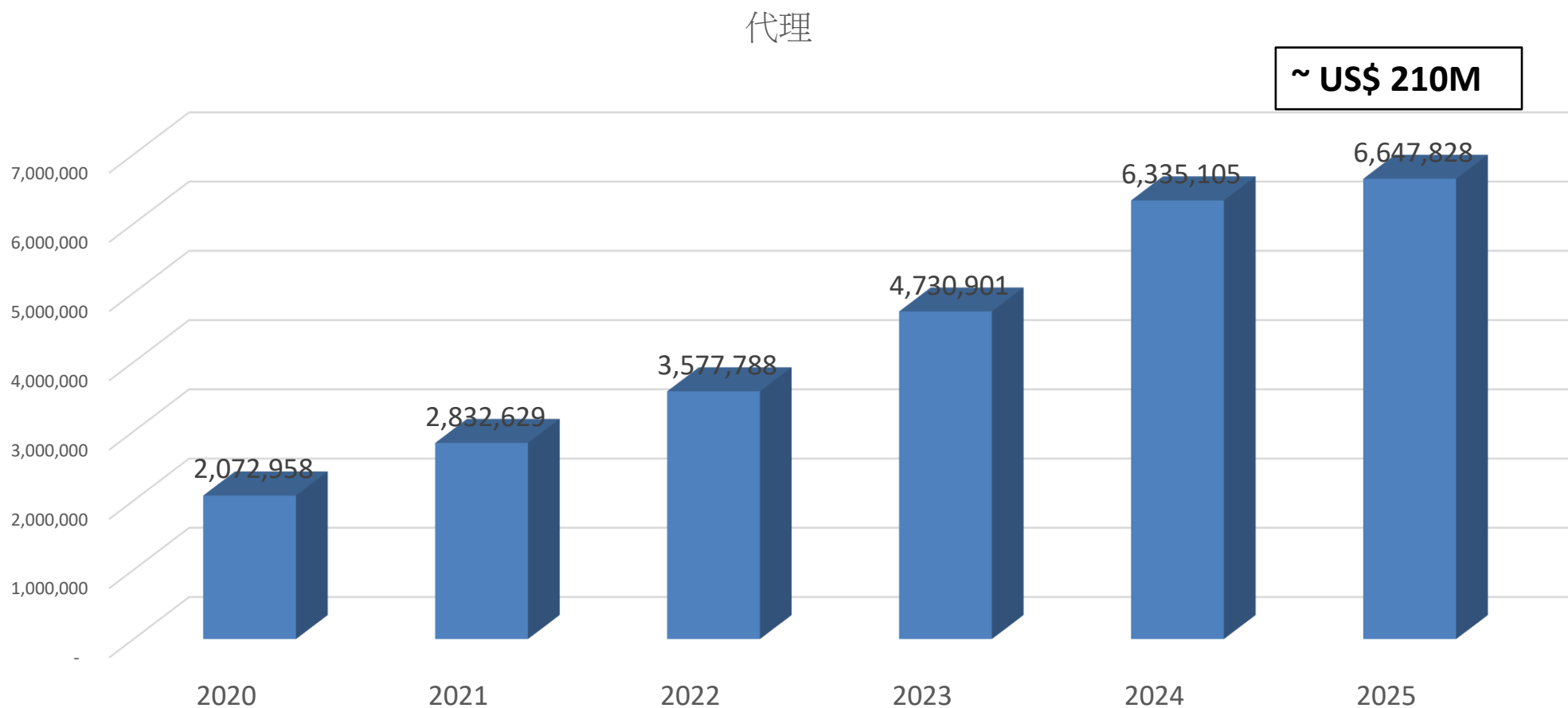
製造業

~ US\$ 150M



代理營業收入

營業收入	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026/Q2	2026
代理	2,072,958	2,832,629	3,577,788	4,730,901	6,335,105	6,647,828	2,958,074	

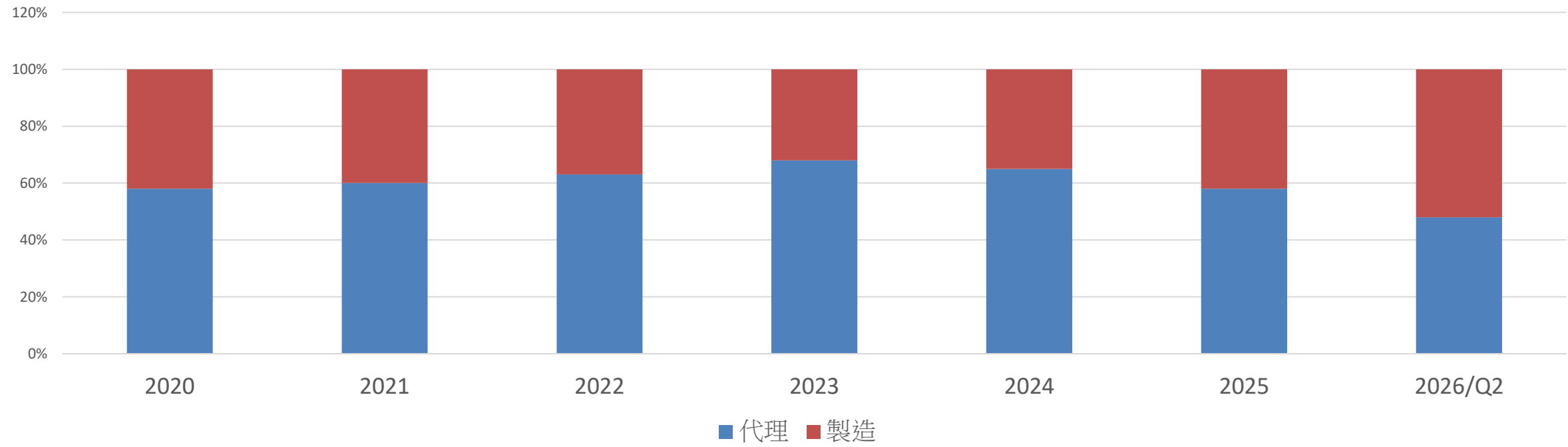


產品組合—營業收入



單位：%	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026/Q2	2026	Gross Margin
代理	58	60	63	68	65	58	48	<50%	Below Average
製造業	42	40	37	32	35	42	52	>50%	Above Average

營業收入



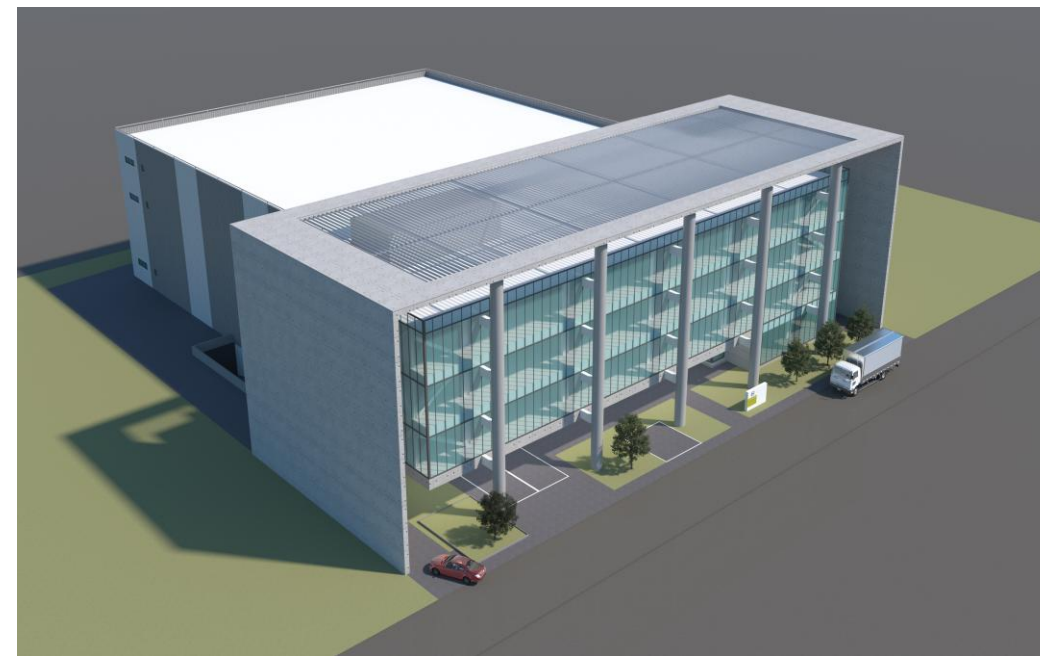
未來展望



- 2023:湖口新建裝備生產基地(異地)。
- 2024:湖口工廠現有設備生產擴建。
- **2025 Q4:**湖口工廠再生晶圓產能再增加5萬片/月。
- **2026 Q1:** 上海新辦公室開幕
- **2026 Q4:**湖口工廠晶圓再生產能再增加4萬片/月。
- **併購: YAYATECH (亞亞) in 2025, Nutrim (新群) in 2026**
- 2027:湖口工廠再生晶圓產能再增加5萬片/月。

擴廠藍圖

- 2026 Q4: 9,000M²(2,700坪) 新廠房（二廠）用於設備製造與倉庫，毗鄰湖口廠（一廠）
- 2028 Q1: 台南新建22,000 M² (6,600坪)的設備製造和倉儲大樓(南臺灣)



資本支出與投資

Capex	NTD K	USD K
Wafer Reclaim 50K Expansion	1,450,000	48,000
Wafer Reclaim 40K Expansion	300,000	10,000
Shanghai Office	180,000	6,000
Hukou Factory II	550,000	18,000
Tainan Factory	850,000	31,000
Sum	3,305,000	113,000

Capex	2024	2025	2026
NTD K	546,000	1,250,000	1,750,000
USD K	18,000	41,000	58,000

Other Invest.	2024	2025	2026
NTD K	215,000	109,000	43,000
USD K	7,000	3,600	1,400

- 半導體複合年增長率將支持我們積極的投資計劃。
- 半導體市場規模
 - 2024: 640B
 - 2025: 750B
 - 2026: 900B – 1Trillion
- TSMC's 法人電話會議:
 - 2024-2029年間，人工智慧加速晶片的複合年成長率預計從mid-40%上調至mid-to-high 50%
 - 2024年至2029年總收入複合年成長率從20%提高到25%

TSMC 2024 Outstanding Suppliers Award



<https://pr.tsmc.com/english/news/3192>

② 混合營收模式 - 兼顧穩定性與成長槓桿:

- 代理商/代理商業務 - 資產輕、利潤率高、穩定
- 晶圓再生-循環經常性收入，穩定性
- 自製設備-營收成長火車頭，人工智慧強勁需求成長

三大產品結構提供:

- 基本經常性收入
- 人工智慧需求帶來的成長潛力
- 波動性低 vs. 純設備型同業波動性較高

市場定位：我們的混合營運模式結合了結構穩定性和人工智慧驅動的成長槓桿。



SCIENTECH

Thank You!

<https://www.scientech.com.tw>